

第40回 薄膜・表面物理基礎講座 (2011年)

「ナノ材料研究者のための表面・界面の評価技術の基礎と動向」

(<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>)

協賛 日本物理学会、日本化学会、日本金属学会、日本表面科学会、電子情報通信学会、電気学会、触媒学会、日本真空協会、電気化学会、表面技術協会、日本顕微鏡学会、高分子学会、精密工学会、日本結晶学会、日本結晶成長学会、日本磁気学会、日本セラミックス協会、日本放射光学会 (依頼中)

ナノデバイスを始めとする多くの研究開発において原子スケールや分子スケールでの構造と物性の制御は不可欠であり、その解析・評価の重要性はますます高まっています。特に、表面や界面が示すユニークな物性の理解には、先端的な解析・評価技術が絶大な役割を果たします。本講座は、表面・界面の構造から電子物性まで、材料の機能と深く関わる評価技術の最先端を担う7名の講師を招き、評価技術の基礎を多角的に学ぶと共に最新動向に関する知見を広めるためのものです。ナノ材料や電子デバイスの研究者、特にこれから評価技術を積極的に活用しようとする研究者や初学者に広く役立つ講座です。

日時：平成23年11月10日(木) 10:00-17:50

場所：産業技術総合研究所臨海副都心センター (別館11階会議室1)

東京都江東区青海2-3-26 Tel. 03-3599-8001

ゆりかもめ 有明駅下車徒歩4分、りんかい線 東京テレポート駅下車徒歩15分

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tokyo_waterfront/tokyo_waterfront_map_main.html (アクセスマップ)

1. プログラム：

日 時	講 演 題 目	講 師
11月10日(木)		
10:00~10:55	収差補正 STEM による界面・表面構造解析	幾原雄一 (東大)
10:55~11:50	集積化ナノプローブによる表面物性評価	永瀬雅夫 (徳島大)
11:50~13:00	昼 食	
13:00~13:55	FT-IR による表面化学構造解析	高萩隆行 (広島大)
13:55~14:50	XAFS 測定の実際	本間徹生 (JASRI)
14:50~15:05	休 憩	
15:05~16:00	半導体界面の電気特性を支配する物理現象	奥村次徳 (首都大)
16:00~16:55	光電子測定と仕事関数・バンドアライメント評価	吉武道子 (NIMS)
16:55~17:50	ESR/EDMR 測定と界面構造解析	梅田享英 (筑波大)

2. 参加費：テキスト代、消費税含む

薄膜・表面物理分科会会員*	応用物理学会会員**・協賛学協会会員	学生***	その他
10,000円	15,000円	3,000円	20,000円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は、分科会会員扱いといたします。現在非会員の方でも参加申込時に薄膜・表面物理分科会(年会費 A:3,000円、B:2,200円)にご入会いただければ、本講座より会員扱いとさせていただきます。下記応物

ホームページより入会登録を行い、仮会員番号取得後、本講座に参加お申し込み下さい。入会決定後、年会費請求書をお送りいたします。本講座参加費と同時に振込しないで下さい。

<http://www.jsap.or.jp/>

**応用物理学会賛助会社の方は、応用物理学会会員扱いといたします。

***学生の場合、会員・非会員とも参加費は同額です。

3. 定員：

65名 (満員になり次第締め切ります。)

4. 参加申込締切：

2011年10月27日(木)

5. 参加申込方法：

下記分科会ホームページ内の登録フォームにて参加登録してください。

<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>

参加登録完了後、下記銀行口座に参加費をご連絡いただいた期日までにお振込ください。原則として参加費の払い戻し、請求書の発行は致しません。

*領収書は当日受付にてお渡しいたします。

6. 参加費振込先：

三井住友銀行 本店営業部 (本店も可)

普通預金 9474715

(社) 応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

(支) 村のツツガツカイワキ・ヒョウソウツツガツカイ

7. 参加費振込締切：

2011年11月2日(水)

8. 内容問合せ先：

影島博之 NTT物性科学基礎研究所

E-mail : kageshima.hiroyuki@lab.ntt.co.jp

喜多浩之 東京大学

E-mail : kita@adam.tu-tokyo.ac.jp

9. 参加問合せ先：

応用物理学会事務局 分科会担当 上村

TEL : 03-5802-0863 FAX : 03-5802-6250

E-mail : divisions@jsap.or.jp